

2-1-1-12 スルーホール SR 垂込み / SR 进入镀通孔 / Solder resist dripped in plated through hole

【特徴】SR が多数のスルーホール内に垂れ込んでいる状態の欠陥

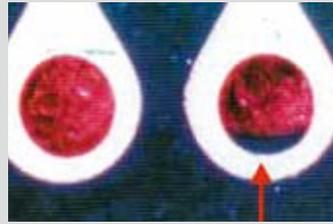
【特征】SR 进入多个镀通孔内的缺陷。

【Characteristics】Solder resist is dripped in many plated through holes

【原因・判断ポイント・発生工程】SR インク粘度が低過ぎた上、印刷版の合わせがズレたり、版裏の汚れや版の破れなどにより出来たもの（SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度太低，网版偏移、网版背面沾污或网版破所造成的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Use of solder resist ink of too low viscosity, misalignment of printing screen, a printing screen with dirty back and/or of a broken printing screen causes the defect. (Solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 55

【注釋】
显微镜倍率 × 55

【Comments】
Magnification: ×55



【コメント】
顕微鏡倍率 × 55

【注釋】
显微镜倍率 × 55

【Comments】
Magnification: ×55

2-1-1-13 バイアホール SR 詰り / SR 堵塞导通孔 / Via hole clogged with solder resist

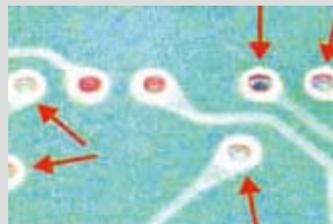
【特徴】バイアホール SR 逃げ仕様の製品で、SR が多数のバイアホール内に詰まっている状態の欠陥

【特征】是导通孔 SR 隔离标准的产品，SR 堵塞在多个导通孔内的缺陷。

【Characteristics】Many via holes are clogged with solder resist in a product with vias specified to be exposed.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR インク粘度が低過ぎた上、印刷版の合わせがズレたり、版裏の汚れや版の破れなどにより出来たもの。PSR の場合は現像液の劣化や現像ノズル詰まりによることもある（SR 印刷工程）

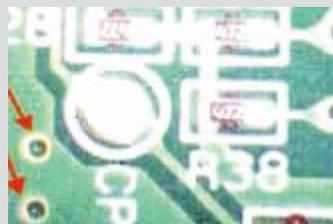
【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度太低，网版偏移、网版背面沾污或者网版破所造成的。而对于 PSR 来说，有时是显影液变质，或者显影喷嘴堵塞所引起的（SR 印刷工序）。



【コメント】
顕微鏡倍率 × 10

【注釋】
显微镜倍率 × 10

【Comments】
Magnification: ×10



【コメント】
顕微鏡倍率 × 5

【注釋】
显微镜倍率 × 5

【Comments】
Magnification: ×5